

/ Revised record

版本	修订日期	有修订的页码	修订涉及的内容	拟制	审核
A	2017-11				
B	2021-2-9	2/8	SS58C的IFSM由175改为150、VF由0.7改为0.85; SS52C VF由0.45改为0.55;更新包装规格	黄超	刘晓荣

SS52C~SS520C

/ Descriptions

表面贴装肖特基整流二极管，反向电压：20~200V，正向电流：5.0A，封装。

/ Features

低功耗，高效率，正向浪涌电流大，适用于低压高频逆变器和极性保护，适用于表面贴装，无卤产品。

/ Applications

一般用途。

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



/ Marking

见印章说明。

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

参数	符号	数值								单位
	()									
										℃
										℃
										℃

)
)



/ Electrical Characteristics(Ta=25)

参数	符号	测试条件	数值						单位
		℃							
		℃							

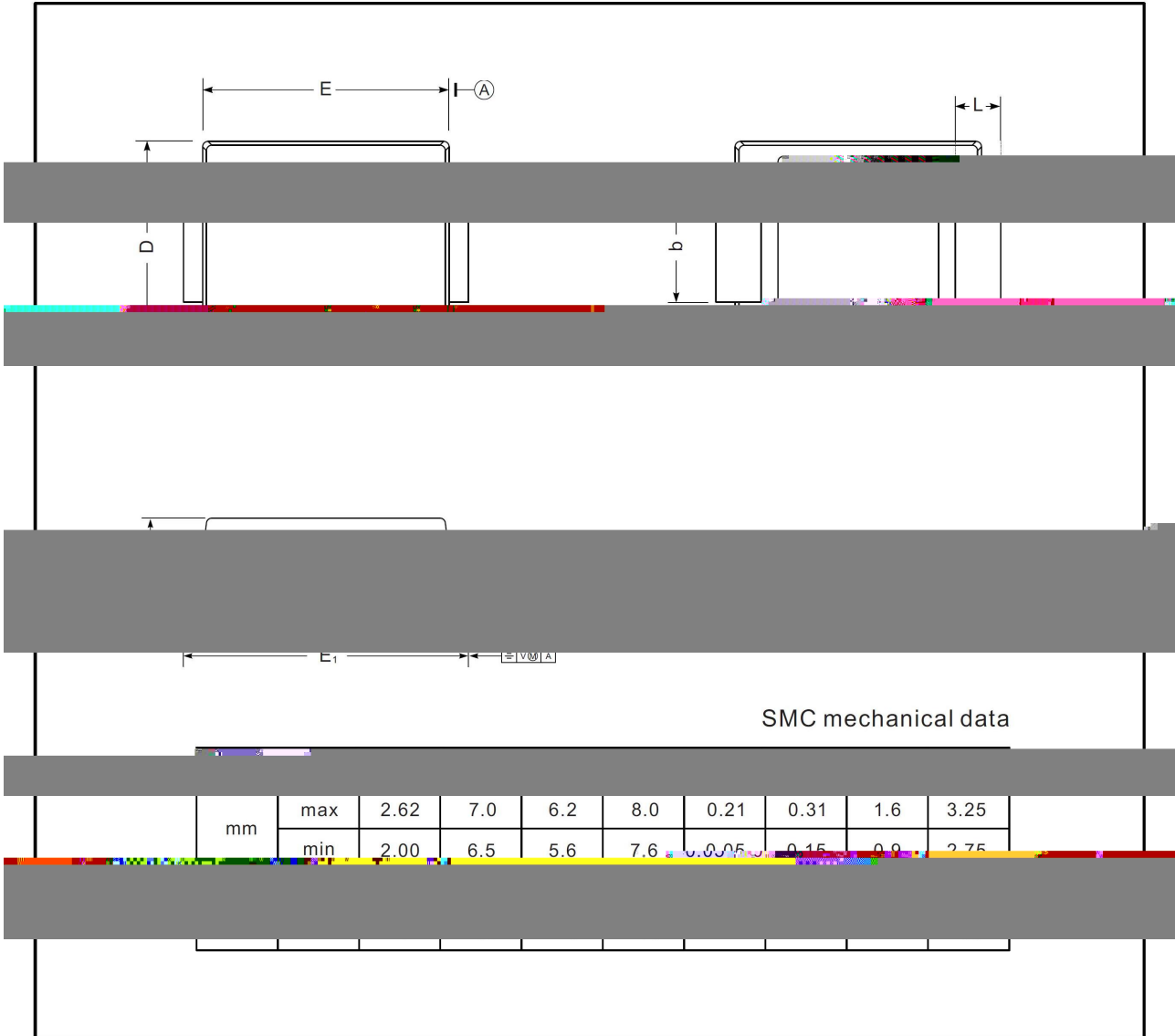
SS52C~SS520C



/ E

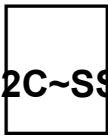
/ Package Dimensions

SMC



SMC mechanical data

mm	max	2.62	7.0	6.2	8.0	0.21	0.31	1.6	3.25
	min	2.00	6.5	5.6	7.6	0.05	0.15	0.9	2.75

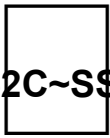


/ Marking Instructions

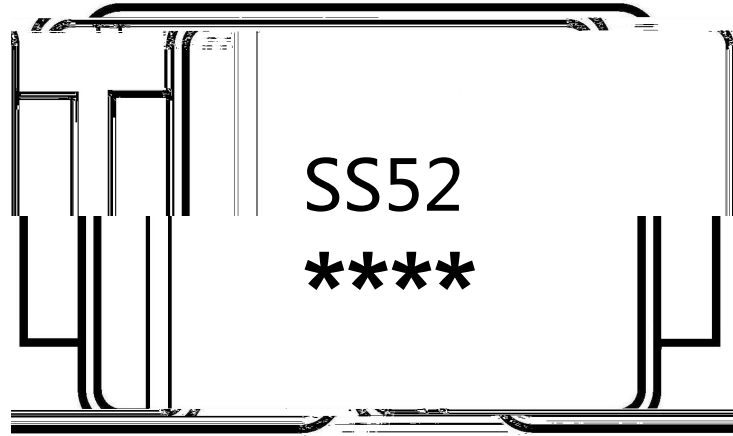
Marking

Type number	Marking code
SS52C	0





/ Marking Instructions



说明

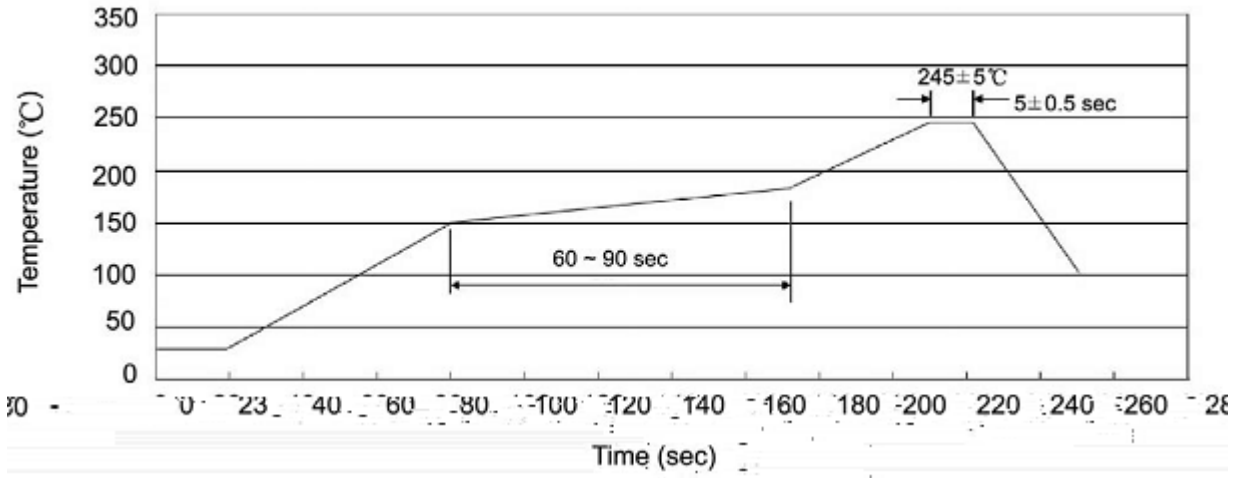
: 为型号代码

: 为生产批号追溯码，第 个 为年月代码，后面 个 为当月小批号代码

:

:

() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

- 、预热温度 ~ °C，时间 ~ °C
- 、峰值温度 ± °C，时间持续为 ± °C ±
- 、焊接制程冷却速度为 ~ °C °C

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度： ± °C 时间： ± ± °C ±

/ Packaging SPEC.

卷盘包装

	只卷盘	卷盘盒	只盒	盒箱	只箱			
						"		

/ Notices